公司代码:600460　　公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2018年末公司的总股本1,312,061,614股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),总计派发现金股利52,482,464.56元。剩余利润转至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电话	0571-88210880	0571-88212980
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司经营范围是:电子元器件,电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。经过将近二十年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。公司属于半导体行业,公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”和“02专项”等多个科研专项课题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	8,126,368,334.95	6,254,406,544.04	6,254,406,544.04	29.93	5,087,803,629.05
营业收入	3,025,857,115.44	2,741,791,759.44	2,741,791,759.44	10.36	2,375,053,756.57
归属于上市公司股东的净利润	170,462,588.85	169,486,597.35	169,486,597.35	0.58	95,891,364.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,656,353.20	98,917,327.53	98,917,327.53	-9.36	23,247,273.08
归属于上市公司股东的净资产	3,427,867,217.69	2,625,597,742.97	2,625,597,742.97	30.56	2,486,791,259.87
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	352,397,124.59	-48.00	381,758,829.38
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.14	-7.14	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	0.14	-7.14	0.08
加权平均净资产收益率(%)	5.12	6.65	6.65	减少1.53个百分点	3.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	650,595,707.32	786,493,675.36	775,075,946.42	813,691,786.34
归属于上市公司股东的净利润	31,137,987.45	64,174,572.90	56,071,345.63	19,078,682.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,192,366.52	48,908,663.22	45,756,594.71	-23,201,271.25
经营活动产生的现金流量净额	-63,152,340.95	52,598,414.73	158,880,877.50	92,269,167.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	142,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

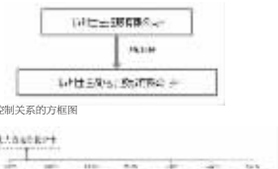
截止报告期末普通股股东总数(户)	142,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州士兰控股有限公司		513,503,234	39.14		质押	132,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		31,071,900	2.37		无		国有法人
厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	21,276,595	1.62	21,276,595	无		国有法人
汇安基金-招商银行-华润保国投信托-华润信托·景睿2号单一资金信托	14,184,397	14,184,397	1.08	14,184,397	无		其他
陈向东		12,349,896	0.94		无		境内自然人
范伟宏		10,613,866	0.81		无		境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	8,443,257	8,443,257	0.64		无		其他
郑少波		8,374,553	0.64		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,188,900	8,358,610	0.64		无		其他
江忠永		8,250,000	0.63		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

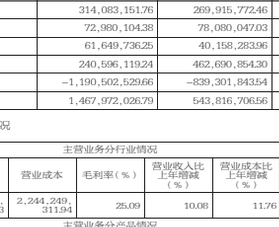
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司营业总收入为302.586万元,较2017年同期增长10.36%;公司营业利润为7.981万元,比2017年同期减少33.06%;公司利润总额为7.992万元,比2017年同期减少32.79%;公司归属于母公司股东的净利润为17.046万元,比2017年同期增加0.58%。公司营业利润和利润总额较去年同期减少的主要原因是:(1)公司子公司士兰集昕公司8吋芯片生产线在报告期内尚未达产,固定成本相对较高,仍有一定数额的亏损。(2)公司子公司士兰明芯公司受LED行业波动的影响,出现了一定数额的亏损。

2018年,公司集成电路的营业收入为963亿元,较去年同期减少9%,公司集成电路营业收入下降的主要原因是:(1)由于传统市场萎缩,公司数字音视频电路的出货量较2017年有较大幅度的下降;(2)受LED下游市场波动的影响,公司LED照明驱动电路的出货量较2017年有所下降。

2018年,公司IPM功率模块产品在国内白色家电(主要是空、冰、洗)、工业变频器等市场继续发力。2018年,国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过300万颗士兰IPM模块,较2017年增加50%,预期今后几年将会继续快速成长。

2018年,公司已成功推出语音识别芯片和应用方案,将会在国内主流的白电厂家的智能家电系统中得到广泛的应用。

2018年,公司已实现微机械硅麦克风的批量生产,并已完成产业布局。今后将广泛应用于白色家电、电动工具、园林工具等各种无线直流电机的控制,预期2019年将会快速形成规模。

2018年,公司成功推出高精度MEMS硅麦克风产品。在目有的芯片制造和封装体系支持下,公司已开发出成系列的MEMS传感器产品:三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器、六轴惯性传感器(内置陀螺仪和加速度计)、压力传感器、光传感器、心率传感器、接麦克风传感器等,这些产品已实现量产出货并在导入量产,已进入智能手机、手环、智能音箱、行车记录仪等消费领域,预计2019年公司MEMS传感器产品的出货量将有较快的增长。

2018年,公司已推出针对智能手机的快充芯片组,以及针对旅充、移动电源和车充的多协议快充解决方案的系列产品,预计2019年上述产品将快速上量。

公司股东达盛、天盛、厦门、西安四地设立了芯片设计研发中心。

2018年,公司分立器件产品的营业收入为14.75亿元,较去年同期增长28.65%。分立器件产品中,低压MOSFET、超结MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块(PIM)、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司8吋芯片生产线产出的较快增长。除了加快在白电、工业控制等市场拓展外,公司已开始规划进入新能源汽车、光伏等市场,预期未来几年公司的分立器件产品将继续快速成长。

2018年,公司子公司士兰集成公司继续保持了较高的生产负荷,并通过挖潜将芯片生产线产能提高至22万片/月。士兰集成全年总计产出芯片239.09万片,比去年同期增加31%;同时产品结构得到进一步优化,芯片制造毛利率得到显著提升。

2018年,公司子公司士兰集昕公司进一步加快8吋芯片生产线投产进度,已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。11月份,士兰集昕月产芯片达到37万片,接近月产芯片4万片的目标。2018年,士兰集昕全年总计产出芯片产品芯片29.86万片,比2017年增加422.94%,这对于推动公司研发的成长起到了积极作用。2019年,士兰集昕将进一步加大对生产线投入,提高芯片产出能力。

2018年,公司子公司成都士兰公司外延车间和模块车间的产出均保持较快增长。模块车间的功率模块封装能力已提升至300万只/月,MEMS产品的封装能力已提升至2000万只/月。2019年,公司还将进一步扩充功率模块和MEMS产品的封装能力。

2018年,公司发光二极管产品的营业收入为5.06亿元,较去年同期减少10%。发光二极管产品收入增长放缓的主要原因是:受LED下游市场需求波动的影响,子公司士兰明芯公司的二极管芯片的营业收入较2017年减少15%。对此,士兰明芯在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快了高亮度白光芯片的开发,加快进入高端LED照明市场。2018年,美卡乐公司通过持续优化工艺,稳定产品质量,降低生产成本,提升产品竞争力,实现营业收入约15%的成长;在高端彩屏市场,“美卡乐”品牌形象得以进一步提升。

2018年,公司已规划在杭州建设一个汽车级功率模块的封装厂,计划第一期投资2亿元,建设一条汽车级功率模块的全自动封装线,加快新能源汽车市场的开拓步伐。

2018年,厦门士兰明镓公司极振谱化合物半导体器件生产线项目建设,2018年12月,化合物芯片生产线项目主体生产厂房已结顶,现正在进行厂房净化装修和动力设备安装,预计2019年下半年将进行试生产。

2018年,厦门士兰集科公司已完成第一条12吋特色工艺芯片生产线项目设计等相关工作。2018年10月,12吋芯片生产线项目主体生产厂房已正式开工建设,相关设备招标工作紧锣密鼓地进行,争取在2020年一季度进入工艺设备安装阶段。

2018年,公司“高速低功耗600V以上多芯片高压模块”项目荣获浙江省科学技术进步一等奖。2018年,公司开发的15A、600V绝缘双栅性晶体管SGT1560ODIP产品被中国电子信息产业发展研究院评为“2018年第十三届中国芯优秀市场表现产品”。

长期以来,士兰微电子坚持走“设计制造一体化”道路,有力地支撑了特色工艺和产品的研发,形成了特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及拥有一条集成电路和模块产品的协同发展,使得8吋芯片生产线项目投产,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋特色工艺芯片生产线项目建设加快推进,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,025,857,115.44	2,741,791,759.44	10.36
营业成本	2,255,612,199.35	2,009,633,731.24	12.24
税金及附加	24,096,412.80	33,480,424.30	-28.03
销售费用	97,388,817.42	88,836,155.86	9.63
管理费用	215,845,975.07	192,024,431.52	12.41
研发费用	314,083,151.76	269,915,772.46	16.36
财务费用	72,980,104.38	78,080,047.03	-6.53
资产减值损失	61,649,736.25	40,158,283.96	53.52
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	-48.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,502,529.66	-839,301,843.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,972,026.79	543,816,706.56	169.94

1.2 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件	2,995,999,726.83	2,244,249,311.94	25.09	10.08	11.76	减少1.13个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路	962,997,349.36	672,243,786.37	30.19	-9	-11.53	增加2.00个百分点
分立器件产品	1,475,304,396.29	1,079,325,846.92	26.84	28.65	30.41	减少0.98个百分点
发光二极管产品	504,923,970.53	444,035,597.90	12.06	-0.05	9.22	减少7.46个百分点
其他	52,774,011.65	48,644,080.75	7.83	361.63	247.56	增加30.25个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
浙江	2,995,999,726.83	2,244,249,311.94	25.09	10.08	11.76	减少1.13个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1)2018年公司营业收入较2017年同期上升了10.08%。公司三大类产品中,公司分立器件产品的营业收入增长较快。分立器件产品中,低压MOSFET、超结MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块(PIM)、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司8吋芯片生产线产出的较快增长。

(2)2018年公司向前5名客户销售合计为50,687.33万元,占公司营业收入的16.92%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
集成电路和分立器件5吋,6吋芯片(万片)	239.09	239.09	26.83	3.51	3.51	-11.95
集成电路和分立器件8吋芯片(万片)	29.86	29.86	5.58	422.94	422.94	210
发光二极管芯片(百万颗)	195,397.22	173,053.63	67,977.14	12.05	22.64	46.01

产销量情况说明

上表中的集成电路与器件5吋、6吋芯片产量、销量、库存量为士兰集成的数据;集成电路和分立器件8吋芯片产量、销量、库存量为士兰集昕的数据。发光二极管芯片产量、销量、库存量为士兰明芯的数据。

集成电路和分立器件8吋芯片库存量增加较多的原因:2018年,士兰集昕8吋线逐步上量,导致在制品投入大幅度增加。

发光二极管库存数量增加较多的主要原因是:2018年,LED下游市场需求出现波动,导致士兰明芯公司发光二极管芯片出货速度放缓。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子元器件		2,244,249,311.94	100	2,008,066,907.05	100	11.76	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路		672,243,786.37	29.95	759,859,744.59	37.84	-11.53	
分立器件产品		1,079,325,846.92	48.09	827,653,827.05	41.22	30.41	
发光二极管产品		444,035,597.90	19.79	406,557,387.69	20.25	9.22	
其他		48,644,080.75	2.17	13,995,947.72	0.70	247.56	

成本分析其他情况说明

1)集成电路和分立器件5,6吋芯片制造成本构成

项目	2018年	2017年
主材	32.50%	31.03%
辅材	19.17%	19.92%
人工	21.13%	21.45%
制造费用	27.20%	27.60%
合计	100.00%	100.00%

2)集成电路和分立器件8吋芯片制造成本构成

项目	2018年	2017年
主材	39.47%	24.46%
辅材	10.55%	12.34%
人工	7.74%	12.54%
制造费用	42.24%	50.66%
合计	100.00%	100.00%

注:8吋线2017年6月底正式投产,由于2017年7-12月芯片产出相对较少,因此8吋芯片制造成本构成中人工和制造费用占比较高。

3)发光二极管芯片制造成本构成

项目	2018年	2017年
主材	21.36%	23.78%
辅材	14.60%	13.49%
人工	19.73%	19.19%
制造费用	44.31%	43.54%
合计	100.00%	100.00%

注:制造费用包括折旧和能源费用等。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额50,687.33万元,占年度销售总额16.92%;其中前五名客户销售额中关联方销售额16,368.78万元,占年度销售总额5.46%。

前五名供应商采购额54,935.91万元,占年度采购总额26.37%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

公司的前五名供应商分别是河北普兴电子科技股份有限公司,天水华天科技股份有限公司,上海合晶硅材料有限公司,深圳市盛元半导体有限公司,麦斯克电子材料有限公司。

1.3 费用

利润表项目	2018年1-12月	2017年1-12月	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	24,096,412.80	33,480,424.30	-28.03	主要系上年同期士兰集成向士兰集昕转让8吋线设备缴纳相应的附加税费。
利息费用	83,186,714.40	64,449,589.90	29.07	主要系本期融资规模扩大利息支出增加所致。
利息收入	6,153,540.66	3,358,782.12	83.21	主要系本期银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	61,649,736.25	40,158,283.96	53.52	主要系本期存货跌价损失增加所致。
投资收益	8,656,177.94	13,315,186.11	-34.99	主要系本期理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	2,090,188.80	-2,027,788.80	不适用	主要系本期黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
资产处置收益	648,005.79	-2,031,766.35	不适用	主要系本期处置的固定资产收益增加所致。
所得税费用	5,666,809.18	16,095,012.59	-64.79	主要系本期利润总额减少导致应纳税所得减少所致。

1.4 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	314,083,151.76
本期资本化研发投入	35,832,325.12
研发投入合计	349,915,476.88
研发投入总额占营业收入比例(%)	11.56
公司研发人员的数量	2,018
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	36.90
研发投入资本化的比重(%)	10.24

情况说明

作为国内半导体领域中以IDM(设计与制造一体化)为主要模式的公司,研发支出主要分为设计研发和制造工艺研发。公司的目标是将以国际上先进的IDM大厂为学习标杆,成为具有自主品牌、具有国际一流竞争力的综合性的半导体产品供应商。围绕这个长期的目标,报告期内,研发项目仍主要围绕电源管理产品平台、功率半导体器件与模块技术、数字音视频技术、射频/模拟技术、MCU/DSP产品平台、MEMS传感器产品与工艺技术平台、发光二极管制造及封装技术平台等几大方面进行。通过这些研发活动,公司不断丰富现有的产品群,譬如推出IGBT、超结MOSFET等功率器件和功率模块产品,推出LED电源电路、数字音视频电路、MCU电路、MEMS传感器等产品,推出高品质的LED芯片和成品。

1.5 现金流

现金流量表项目	2018年1-12月	2017年1-12月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	240,596,119.24	462,690,854.30	-48.00	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,502,529.66	-839,301,843.54	不适用	主要系本期收回投资收到的现金减少,投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,972,026.79	543,816,706.56	169.94	主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受追要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	312,170,357.73	应收票据及应收账款	1,033,059,480.76
应收账款	720,889,123.03		
应付票据	145,550,402.17	应付票据及应付账款	704,508,783.68
应付账款	558,958,381.51		
应付利息	2,321,822.67	其他应付款	6,291,513.05
其他应付款	3,969,690.38		
管理费用	461,940,203.98	管理费用	192,024,431.52
		研发费用	269,915,772.46
收到其他与经营活动有关的现金[注]	92,958,694.46	收到其他与经营活动有关的现金	203,252,424.17
收到其他与投资活动有关的现金[注]	135,592,107.10	收到其他与投资活动有关的现金	25,298,377.39

[注]:1.将实际收到的与资产相关的政府补助110,293,729.71元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用□不适用

本公司将杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州博脉科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司、士兰明芯科技有限公司、Silan Electronics,Ltd、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司、成都集佳科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州华投资有限公司、无锡博脉智能科技有限公司、厦门士兰微电子有限公司(以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、博脉公司、美卡乐公司、士港公司、士兰BVI公司、成都士兰公司、深兰微公司、集佳科技公司、士兰集昕公司、集华投资公司、无锡博脉公司、厦门士兰微公司)等14家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见年度报告财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事长:陈向东

2019年3月28日

证券代码:600460　证券简称:士兰微　编号:临2019-007

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2019年3月18日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并以电话或短信的方式确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议通过了以下决议:

1、《2018年年度报告》及摘要

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2、《2018年度总经理工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4、《2018年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5、《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润170,462,588.85元(合并口径),2018年度母公司实现净利润230,763,263.62元,依据《公司法》和公司章程的规定,提取10%法定公积金后,母公司当年可供股东分配的利润为207,686,937.26元,加上上年结转未分配利润944,498,254.92元,再减去报告期内已经派发的2017年度现金股利52,482,464.56元,截至期末母公司累计可供股东分配的利润为1,099,702,727.62元。

本公司2018年度的利润分配的预案为:拟以2018年末公司的总股本1,312,061,614股为基数,每10股派发现金股利0.40元(含税),总计派发现金股利52,482,464.56元。剩余利润转至以后年度分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

6、《2018年度公司内部控制评价报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、《2018年度社会责任报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-009。

表决结果:关联董事陈向东、罗伟长回避表决,10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

9、《关于与厦门士兰集科关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-010。

表决结果:关联董事陈向东、范伟宏、王汇联先生回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司支付关健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告审计报酬共计96万元人民币。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的年度财务报告进行审计机构,并确定其2019年度财务报告审计报酬为100万元(若有其他事项,报酬另议)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

11、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2019-011。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为满足2019年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,董事会拟同意在2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过267,000万元,其中:

(1)对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过70,000万元;

(2)对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过50,000万元;

(3)对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过15,000万元;

(4)对成都集佳科技有限公司担保不超过6,000万元;

(5)对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元;

(6)对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过15,000万元;

(7)对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过110,000万元。

(以上金额包含2018年度延续至2019年度的担保余额,且在2019年年度股东大会召开前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。)

2019年3月28日,公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

二、被担保人截至2018年12月31日的基本情况

1、各公司的基本情况如下:

(单位:人民币　万元)

公司名称	注册地	注册资本	法定代表人	股权比例	经营范围
杭州士兰集成电路有限公司	浙江杭州	60,000	陈向东	98.75%	集成电路、半导体、分立器件的制造和销售;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。
杭州士兰明芯科技有限公司	浙江杭州	85,000	范伟宏	99.78%	设计、制造发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备;销售自产产品;货物进出口;其它无需报经审批的一切合法项目。
成都士兰半导体制造有限公司	四川成都	70,000	陈向东	100%	集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售;货物进出口。
成都集佳科技有限公司	四川成都	18,000	范伟宏	100%	集成电路、半导体分立器件、功率模块等半导体产品的设计、制造、销售;货物进出口。
杭州士兰光电技术有限公司	浙江杭州	2,000	陈向东	80%	设计、开发、生产光电模块、光电器件等相关产品及提供相关服务;销售自产产品。
杭州美卡乐光电有限公司	浙江杭州	15,000	江忠永	99.87%	设计、生产:发光二极管;销售自产产品;技术转让:发光二极管;货物进出口。
杭州士兰集昕微电子有限公司(以下简称“士兰集昕”)	浙江杭州	125,940	陈向东	47.3(注)	制造、销售:8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块;销售:8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料;8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让;批发、零售:机械设备及零配件、仪器仪表;货物及技术进出口。

注:本公司直接持有士兰集昕9.80%股权,并通过控股子公司集华投资、士兰集成间接控制士兰集昕37.50%股权,且本公司在士兰集昕占有2/3董事会席位,对其实施控制。本公司控股出资比例直接及间接享有士兰集昕31.74%所有者权益份额。

2、截至2018年12月31日,各公司经营情况如下:

(单位:人民币万元)

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
杭州士兰集成电路有限公司	167,918.38	84,238.37	83,680.01	11,624.48	50.17%
杭州士兰明芯科技有限公司	129,157.95	51,337.06	77,820.89	-2,671.06	39.75%
成都士兰半导体制造有限公司	79,932.41	8,731.80	71,200.61	1,837.94	10.92%
成都集佳科技有限公司	18,118.63	3,635.73	14,482.89	-1,374.95	20.07%
杭州士兰光电技术有限公司	6,268.29	1,928.93	4,339.36	419.54	30.77%
杭州美卡乐光电有限公司	32,522.37	18,484.07	14,038.30	-641.50	56.83%
杭州士兰集昕微电子有限公司	201,954.16	94,256.98	107,697.18	-13,901.00	46.67%

3、杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、成都集佳科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司均为本公司全资子公司或者控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订具体担保协议,2019年度本公司将根据以上公司的申请,根据资金需求予以安排。

四、董事会意见

2019年3月28日,公司召开了第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事认为:

1、公司拟为全资子公司及控股子公司提供的担保,是满足公司正常经营业务的需要,是充分、合理的。

2、2019年度的担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

3、上述被担保人均为公司全资或控股子公司,该担保事项有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度为对全资子公司及控股子公司提供担保,担保总额不超过267,000万元,其中:

(1)对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过70,000万元;

(2)对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过50,000万元;

(3)对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过15,000万元;

(4)对成都集佳科技